

第 26 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 24 年 7 月 26 日（木） 13：15～16：30
場所： 東京：東京事務所 4F 401、402、403 及び 404 会議室
筑波：総合開発推進棟 2F 中会議室 b2
(東京⇄筑波テレビ会議設定)

1. 開会の挨拶
2. 部品ユーザからの情報 (13：15－13：45 30分)
(不具合、調達上の問題、今後期待する部品と技術など)
 - ・三菱プレシジョン
3. 部品メーカーからの報告 (13：45－14：25 40分)
 - 3.1 SOI ASIC のパッケージ追加 (HIREC)
 - 3.2 表面実装用小形大容量積層セラミックコンデンサの認定 (福井村田製作所)
 - 3.3 ヒューズの工程変更報告 (立山科学デバイステクノロジー)
 - 3.4 固定巻線 (電力形、シャーシ取付) 抵抗器の材料変更 (セイデンテクノ)
4. 部品生産のスケジュールに関して (14：25－14：45 20分)
 - 4.1 パワーMOSFET (富士電機)
 - 4.2 POL の状況報告 (日本アビオニクス)
- ◆休憩◆ (14：45－15：05 20分)
5. JAXA からの報告 (15：05－15：25 20分)
 - 5.1 HR5000S に関して
6. QPL/QML 部品認定状況、その他活動報告 (15：25－15：45 20分)
 - 6.1 共通部品等の認定状況
 - 6.2 QTS/ADS の改定状況
 - 6.3 認定部品の変更管理状況
 - 6.4 今年度の QCI 実施計画
7. 海外情報 (15：45－16：25 40分)
 - 7.1 海外宇宙機関 関連情報
 - 7.2 G12/11 報告
 - 7.3 PPBI 報告 (HIREC)
8. その他 (16：25－16：30 5分)
 - 8.1 部品 PO からの報告
 - 8.2 今年度の行事及び予定
9. 閉会の挨拶